

平成30年2月吉日

東京都新宿区西新宿7丁目2番6号
株式会社 ホクリン
代表取締役社長 酒井正秋

子会社の吸収合併に関するお知らせ

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度当社は平成30年4月1日をもって、当社の100%子会社である株式会社デンサン(以下「デンサン」)を吸収合併することと致しましたのでご通知申し上げます。

当社は、平成26年9月にデンサンの株式100%を取得して以降、デンサンの強みと当社の強みを融合し、グループとしての総合力を高める努力をして参りました。具体的には、デンサンで生損保業界向けシステム開発やハード・ソフト一体型でのソリューションの提供に強みを持つシステム開発部門、看板や建物内外のサインを中心とした広告部門と、当社のシステム開発部門、ビルメン部門との一体化によるシナジー効果を追及して参りました。さらには、現在デンサンのネットワーク部門を拡充し、LAN、電話、セキュリティなどワンストップのネットワーク構築業務を新たな強みとすべく準備中です。

合併後は両社がひとつとなり、新生ホクリンとして従来以上に幅広く速やかにお客さまのお役に立てるよう鋭意努力して参る所存です。

何卒、これからも末永くお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

末筆ながら貴社のますますのご発展とご同様のますますのご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げます。

敬白